

利扬芯片：把握行业模式变革，助力芯片国产替代

——广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

广东利扬芯片测试股份有限公司 董事长黄江先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：

大家好！我是广东利扬芯片测试股份有限公司董事长黄江。今天很高兴能够通过网络，与各位投资者朋友就利扬芯片首次公开发行股票并在科创板上市进行实时在线交流。在此，我谨代表公司向参加今天交流活动的各位朋友表示热烈欢迎，向关心和支持利扬芯片发展的各界朋友表示衷心的感谢！同时也感谢“上证路演中心”和“中国证券网”的大力支持！

利扬芯片自成立以来，在集成电路测试领域积累了多项自主的核心技术，已累计研发 33 大类芯片测试解决方案，完成超过 3000 种芯片型号的量产测试，可适用于不同终端应用场景的测试需求。公司产品已广泛应用于：(1)5G 通讯芯片领域(RF、PA、FPGA、LNA 等)；(2) 传感器芯片领域

(MEMS、生物识别、辅助驾驶、消防安全等)；(3)智能可穿戴芯片领域(物联网、人脸识别、智能家居等)；(4)计算类芯片领域(人工智能、区块链、服务器、云计算等)。

芯片测试是对电路、性能等检测，有别于封装、制造，是芯片质量最后的保障，所以每颗芯片都必须经过 100% 测试。随着芯片的日趋复杂，对芯片的测试已不仅是判断能不能用的简单测试。根据有关规定，芯片测试与芯片设计、芯片制造、芯片封装等企业享受同等扶持政策。公司将践行自己的商业模式，对未来的发展充满信心。

随着中国芯片国产替代的不断推进，芯片测试的市场空间巨大。公司近 3 年的复合增长率均高于集成电路产业链上的芯片设计、芯片制造、芯片封装等企业的平均增速。公司坚信，未来专业芯片测试业亦会是成长最快的行业之一。

本次在科创板发行上市，公司将成为中国 A 股市场集成电路独立测试第一股，这将是利扬芯片发展历史上的一次重要跨越。公司将以本次发行上市为契机，全面提升公司综合实力，保持公司的领先优势，捍卫芯片测试行业地位，确保公司持续、高速、健康发展，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。

利扬芯片能成为科创板上市公司，是一份荣耀，更是一份责任！今后，我们会一如既往，再接再厉，以更加优秀的业绩回馈广大投资者，回报社会！中国“芯”加油！谢谢大家！



出席嘉宾

广东利扬芯片测试股份有限公司董事长
广东利扬芯片测试股份有限公司董事、总经理
广东利扬芯片测试股份有限公司董事、董事会秘书
广东利扬芯片测试股份有限公司财务总监

黄江先生
张亦锋先生
辜诗涛先生
杨恩慧女士

东莞证券投资银行部保荐业务副总经理、业务董事、保荐代表人
东莞证券投资银行部业务董事、保荐代表人

王睿先生
张晓晓先生

东莞证券投资银行部保荐业务副总经理、 业务董事、保荐代表人王睿先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：

大家好！我谨代表本次广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的保荐机构和主承销商东莞证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

利扬芯片是国内知名的独立第三方集成电路测试服务商，主营业务包括

集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。在与利扬芯片的合作过程中，我们被公司经营管理团队表现出来的高效、敬业精神所鼓舞，被整个公司体现的专注、创新精神所感染。能为利扬芯片这样优秀的企业服务，我们深感荣幸！

作为本次发行的保荐机构和主承销商，东莞证券必将牢记自己为资本市场服务的使命，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责，与各家中介机构共同努力，本着自律、公平、公正的原则做好利扬芯片首次公开发行工作。同时，我们也真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解利扬芯片，从而更充分地认识利扬芯片的投资价值，把握投资机会。我们对利扬芯片的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问。最后，预祝利扬芯片首次公开发行并在科创板上市圆满成功！

谢谢大家！

经营篇

问：请介绍一下公司的主要经营情况。

黄江：公司是国内知名的独立第三方集成电路测试服务商，主营业务包括集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英寸等晶圆测试服务（简称“中测”、“Chip Probing”或“CP”）、芯片成品测试服务（简称“成测”、“Final Test”或“FT”）以及与集成电路测试相关的配套服务。报告期内，公司为汇顶科技、全志科技、国民技术、东软载波、锐能微、比特微、西南集成、中兴微、智芯微、紫光同芯、集创北方、博雅科技、华大半导体、高云半导体等众多行业内知名的芯片设计企业提供测试服务。

问：公司科研实力如何？

张亦锋：公司所处行业属于技术密集型行业，技术创新能力是行业内企业获得持续发展的主要动力。公司自成立以来，通过持续多年的研发投入和技术积累，在集成电路测试领域已积累了一定的技术优势，拥有较强的自主开发测试方案的能力，得到了众多知名客户的认可，并建立了长期稳定的合作关系。

发行人的主要核心技术来源于自主研发，相关技术在生产应用过程中不断升级和积累，并运用于公司的主要产品中。截至本招股说明书签署日，公司及其子公司取得 85 项专利、8 项软件著作权。自成立以来，公司对集成电路测试领域核心技术的发展持续关注和跟踪并深入研究开发，通过不断加大技术研究和产品开发投入力度，对公司的技术不断进行改进和创新，公司的技术水平得到了很大的提高和改善。报告期内，公司针对核心技术持续增加专利申请。

问：请介绍一下公司的盈利模式。

张亦锋：公司作为国内知名的独立第三方集成电路测试服务商，凭借自主开发的芯片测试技术、高端的芯片测试设备以及无尘化的芯片洁净测试环境，向芯片设计公司提供测试方案开发、晶圆测试、芯片成品测试等服务，从中取得收入、获得盈利。公司所从事的集成电路测试属于技术含量高、人才密集、资金密集的高科技现代服务业，公司的发展符合集成电路行业的特点和发展趋势。公司将不断地提升运营管理能力和生产效率，降低生产成本，提升自身技术水平和服务能力，增加市场份额，以期在未来获得更多的收入和利润。

发展篇

问：请介绍一下公司整体发展战略。

黄江：公司的核心业务为集成电路测试服务。公司将坚持自主创新的发展道路，不断提高研发与创新能力，提升服务技术水平，从而进一步提高在国内市场的占有率，努力将公司发展成为国内领先、世界知名的集成电路测试服务商。

公司通过多年的技术积累，在集成电路测试方案开发、晶圆测试以及芯片成品测试等领域均积累了丰富的核心技术成果，拥有较强的自主开发测试方案能力。市场需求的不断增长，给公司发展带来了良好的发展机遇。公司将围绕已经确定的发展战略，密切跟进集成电路行业发展趋势，了解目标客户需求，做好自主创新与借鉴学习的结合，不断提高研发与创新能力。公司将调

配内部各项资源、加快推进募投项目建设，研发、销售规模和能力将得以扩张，为未来高效全面的集成电路测试服务提供重要支持。

问：专业测试细分市场及未来的变化趋势是什么？

张亦锋：近年来，随着国民经济的快速发展、产业升级等对传统经济的深入改造及发达国家地区集成电路产业逐渐向发展中国家进行战略转移，芯片国产化的比例不断提升，国内集成电路行业整体上呈现蓬勃发展的态势。芯片产业链的各个细分行业，包括公司所处的集成电路测试行业均取得了快速增长，未来的发展空间巨大。现阶段，国家要大力发展集成电路产业，明确了集成电路产业的电子核心产业地位，集成电路测试是其中非常关键的一环，公司的业务面向国家重大需求，符合国家战略发展方向。未来，在国内集成电路产业发展的带动下，中国集成电路测试行业发展潜力巨大。

另外，近年来 Chipless 模式的发展，也给公司带来了很大的发展机遇。所谓 Chipless 模式，就是如苹果、华为这类拥有巨大终端产品市场的品牌公司，成立专门的芯片设计团队进行自主芯片的设计和研发，同时掌握前端的芯片设计和后端应用两大关键环节，并将中间的晶圆制造、芯片封装、集成电路测试环节委托专业化的代工厂完成的商业模式。该模式的企业，大力投入适用于自家产品的专业芯片及自有系统级芯片（SoC）的研发和设计，以图减少对传统 IDM 模式企业的依赖，使得 IDM 模式占据的市场份额将进一步减少，而专业分工模式市场份额将增大，进而使得独立第三方测试企业的市场份额将进一步扩大，有利于公司的发展。

问：公司在测试平台有什么竞争优势？

张亦锋：公司成立于 2010 年，经过近 10 年的发展，积累了较多的测试平台。相比于国内其他独立第三方测试公司，发行人测试平台类型较为多样和丰富，可满足市场上不同设计公司的测试需求。目前，发行人拥有爱德万 93K、T2K、T5 系列，EVA100，泰瑞达 J750、Magnum、Chroma 33XX 系列，NI STS 系列，Accotest STS8200，Sandtek Astar、Ostar，TEL P12、Precio XL，TSK UF200、UF3000、Multi-Test M9510，Epson 8000 系列等测试设备，具有存储器芯片、消费类电子芯片、逻辑和混合信号芯片、无线射频芯片、系统级芯片、生物芯片和 MEMS 芯片等的测试能力。

行业篇

问：请介绍一下公司所处行业。

张亦锋：公司主营业务为集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C 制造业”门类下的“C3973 集成电路制造”；根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C 制造业”门类下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1.新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.4 集成电路制造”。

问：公司测试的芯片产品主要应用于哪些领域？

张亦锋：主要应用领域包括：（1）5G 通讯（RF、PA、FPGA、LNA、Switch 等）；（2）传感器（MEMS、心率监测、生物识别、消防安全等）；（3）智能可穿戴（物联网 IoT、人脸识别、智能家居等）；（4）汽车电子（车联网、胎压监控、自动驾驶、ETC 等）；（5）计算类芯片（人工智能 AI、服务器、区块链、云计算等）；（6）北斗应用（雷达、导航、定位等）；（7）工业类和消费类产品（医疗电子、电表应用、智能手机等）；（8）信息安全（金融 IC 卡、加密算法、U-KEY 等）。

问：公司的市场地位如何？

张亦锋：公司经过多年的发展，已发展成为国内最大的独立第三方集成电路测试基地之一。公司为民营科技型企业、国家级高新技术企业，并被广东省科学技术厅认定为广东省超大规模集成电路测试工程技术研究中心。

自创立之初，公司就定位于建立 12 英寸晶圆级测试能力，同时向下兼容 8 英寸晶圆级测试。公司较早地实现了多项高端芯片的测试量产，已累计研发 33 大类芯片测试解决方案，可适用于不同终端应用场景的测试需求，完成超过 3000 种芯片型号的量产测试。

发行篇

问：请介绍一下募集资金投资概况。

张亦锋：公司募投项目的投资总额为 56285.40 万元。芯片测试产能建设项目投资总额 40991.20 万元，研发中心建设项目投资总额 10294.20 万元，补充流动资金 5000.00 万元。募集资金投资于以下项目：

1.芯片测试产能建设项目

本项目为公司主营业务产能扩充项目，主要建设目的为提高公司晶圆测试、芯片成品测试等主要服务的能力，相关服务均属于科技创新领域。

2.研发中心建设项目

公司拟通过研发中心建设项目进一步引进集成电路测试领域的优秀研发人才，购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。项目投向属于科技创新领域。

问：针对本次发行，公司是否已从发展战略、产业布局、技术、人才等方面做好准备？

黄江：公司所处行业属于技术密集型行业，技术创新能力是行业内企业获得持续发展的主要动力。公司自成立以来，通过持续多年的研发投入和技术积累，在集成电路测试领域已积累了一定的技术优势，拥有较强的自主开发测试方案的能力，得到了众多知名客户的认可，并建立了长期稳定的合作关系。

公司的主要核心技术来源于自主研发，相关技术在生产应用过程中不断升级和积累，并运用于公司的主要产品中。自成立以来，公司对集成电路测试领域核心技术的发展持续关注和跟踪并深入研究开发，通过不断加大技术研究和产品开发投入力度，对公司的技术不断进行改进和创新，公司的技术水平得到了很大的提高和改善。

展望未来，在发展战略、人才储备、技术研发等方面，公司做好了全面的准备。

广东利扬芯片测试股份有限公司 董事、董事会秘书辜诗涛先生致结束语



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友们：

大家好！3 个小时的网上路演就要结束了，非常感谢各位投资者朋友热情、友善的交流，以及对利扬芯片的关心、信任和支持！非常感谢上证路演中心和中国证券网提供的良好服务！非常感谢保荐机构和主承销商东莞证券股份有限公司及所有参与

发行工作的中介机构所付出的辛勤劳动！

刚才的交流中，我们共同探讨了公司的业务状况、财务状况、发展战略、公司治理等，大家提出了很多非常有价值的意见和建议，我们回去后会认真进行梳理，把朋友们的真知灼见融入到公司的经营管理中，创造更好的业绩来感谢大家的关心与厚爱。

同时，我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者和社会公众的关注、关心与监督，我们一定不辜负社会各界和投资者的期望，把利扬芯片打造成一家治理规范、决策科学、市场领先的上市公司，实现股东价值、员工价值和社会价值最大化。

我真诚希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，公司今后也将积极创造条件，保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。

谢谢大家！

文字整理 余筱雯

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)